

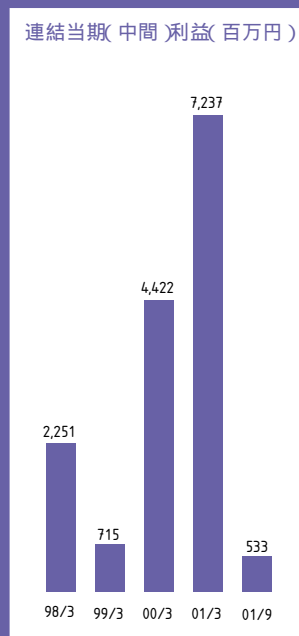
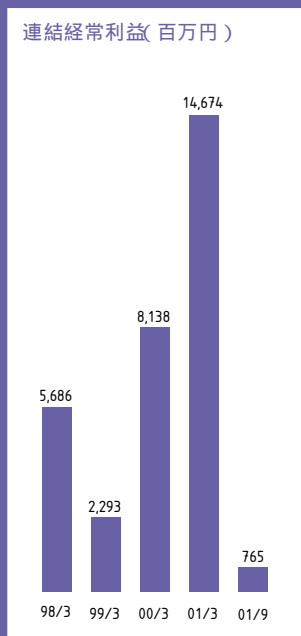
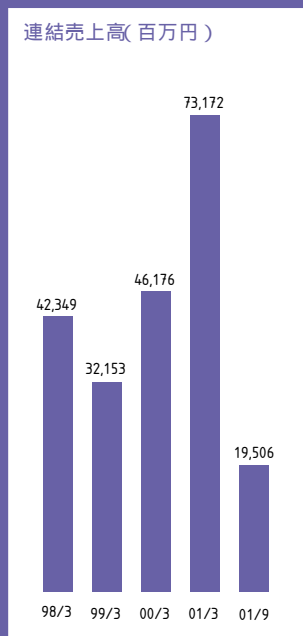
第 79 期

中間事業報告書



株式会社東京精密

## 財務ハイライト



	1998/3	1999/3	2000/3	2001/3	2001/9 (中間期)
連結売上高	42,349	32,153	46,176	73,172	19,506
連結経常利益	5,686	2,293	8,138	14,674	765
連結当期(中間)利益	2,251	715	4,422	7,237	533
連結総資産	46,163	41,309	61,007	91,477	83,504
連結純資産	27,604	28,437	33,433	38,779	37,769
発行済株式総数(千株)	36,575	37,004	37,543	37,465	37,273
1株当たり連結当期(中間)利益(円)	63.87	19.41	118.43	192.95	14.25

1株当たり連結当期(中間)利益は、期中の平均株式数により算出しています。

## 株主の皆様へ

東京精密の株式を保有して頂き、有難う存じます。厚く御礼申し上げます。

さて、当社は、株主の皆様が当社株式を保有していただいた目的に沿った経営を目指しております。

当社は、経営指標といたしましては、一株当たりの純利益（EPS）を長期的に増大させていく事を重視しております。会社にとっては、企業価値を長期的に増大させることになりましますし、株主の皆様のご期待に応えることになると考えます。これは当社のモットーであるWIN-WINの関係を株主の皆様と会社との間で作り上げる事につながると確信しております。

当社は、技術指向型の会社です。上記の目的のために、当社は次の「製品開発の原則」に沿って技術開発を継続的に行ってまいります。

### 1. 世界No.1の製品を創る。

マーケットシェアNo.1の商品は

- (1) 好況時は、利益の極大化を図れる。
- (2) 不況時は、損失の極小化を図れる。

### 2. 研究開発投資は自己資金で。

### 3. 技術参入障壁が高く、マーケットが大きくニーズも高い分野を狙う。

### 4. 市場規模が停滞縮小傾向にあるが、ユーザーとの関係で、今後もR&D投資が必要な製品は、競合先であってもアライアンスを組み、R&Dコストをシェアする。

この原則を守るためには、各国、各社の持つ異文化を包摂したグローバルかつハイブリッドな東京精密の文化風土を醸成しなければなりません。そこで、「WIN-WINの仕事で世界No.1の商品を創ろう」というモットーを制定し、世界No.1の商品開発体制の構築に努めてまいりました。

さらに、本年1月には「ACCURETECH(アクレーテク)」というコーポレートブランドを導入しました。「ACCURETECH」は、共に成長するという意味の「ACCURETE」と「TECHNOLOGY」を組み合わせた合成語で、「世界中の優れた技術・知恵・情報を融合して、世界No.1の商品を創り出し、皆様と共に大きく成長していく」という当社の企業理念を一語で表したものです。

株主の皆様にも是非当社の企業理念にご賛同賜り、このコーポレートブランド「ACCURETECH」のもと、更なる飛躍を目指す当社に、今後とも格別なるご理解とご支援をお願い申し上げます。

代表取締役社長  
大坪 英夫

大坪英夫

代表取締役社長  
大坪 英夫



# FAQ

## -よくあるご質問

Q. 東京精密グループの中長期的な戦略を教えてください。

A. 当社は、独自の「製品開発の原則」(詳細は1頁をご参照下さい。)を経営の大原則として、市場の設備投資動向の影響を最小限に抑えつつ、成長市場に経営資源を集中させ、高成長・高収益なビジネス基盤を構築し、さらなる企業価値の向上に努めております。

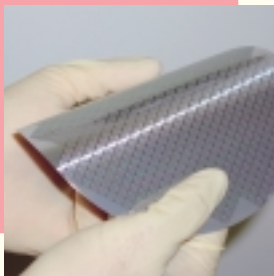
具体的には、「技術参入障壁が高く、マーケットが大きく、ニーズも高い分野」である半導体製造装置の中でも特に革新的な技術が求められている前工程(ウェーハプロセス)の装置の開発に近年注力しております。前工程は半導体製造の中心として位置付けられており、半導体製造装置向け設備投資の総額の70%以上を占めます。近年、当社が新規参入しました市場は、半導体生産の歩留まり向上に貢献す

るウェーハ外観検査装置、半導体デバイスの微細化・高密度化・多層配線等に不可欠なウェーハ表面を平坦化させるCMP装置、半導体デバイスの薄片化・小型化・大容量化に威力を発揮するポリッシュ・グラインダです。また、昨年6月より、半導体デバイスの微細化・高集積化の中核技術で、最も大きな技術的・経済的ブレークスルーが必要とされている次世代リソグラフィ装置LEEPLを開発しており、2003年4月頃、市場投入する予定です。これらの新製品により、当社は、テスト及び後工程型製造装置メーカーから前工程型メーカーへ移行し、今後益々拡大が予想される半導体製造装置市場と共に大きく飛躍することを目指しています。

CMP装置「A-FP-210A」



ポリッシュ・グラインダで加工後の、薄くて(30ミクロン)強度の高いウェーハ



Q. 東京精密の製品開発体制について教えてください。

A. 当社は、1988年より独自のグループリーダー制を採用しています。当社の開発部門は、製品群別にグループ化され、各グループのヘッドであるグループリーダーは、製品開発のみならず、担当する製品群の業績全般についての責任を持っています。そのため、グループリーダーは、事業計画作成、設備投資及び人材の採用など大きな権限を与えられており、開発計画などの意思決定をスピーディーに行うことができ、市場動向にも迅速かつ柔軟に対応できる

という利点を備えています。したがって、各技術グループは、少数精鋭でコア事業に特化するベンチャー企業に似ており、ベンチャー企業の特質である強い創造力も備えています。

近年、新しい分野の製品開発に注力しています。その場合、新しいグループが創られます。新しい分野であるため、多くの場合、国内外、社内外からその分野の開発に実績がある技術者が集まってグループが形成され、その中からグループリーダーが選ばれます。

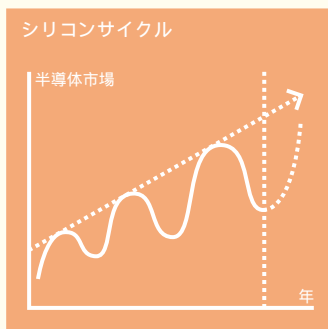
市場ニーズに合致した製品のスピード開発が成功の大きな鍵となっている今、グループリーダー制は、機動力・創造性・柔軟性に富む非常に効率的な体制と考えられています。

八王子工場内クラス10クリーンルーム(写真の装置はウェーハ外観検査装置「WIN-WIN 50」)

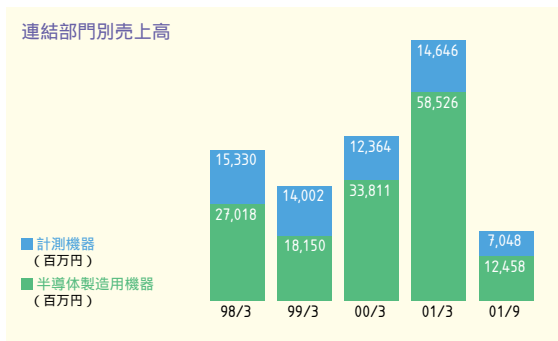


Q. 今年の半導体業界は未曾有の大不況で、業績も前期と比べ大幅に落ち込むようですが、こういうことは、よくあるのですか？

A. 今、半導体業界は、シリコンサイクルの底で低迷しています。シリコンサイクルとは、技術革新の速さから、半導体製品のライフサイクルが非常に短く、新世代のICが登場すると価格は高騰しますが、市場が拡大して十分普及すると価格は下落を始め、ついには暴落し、再び新世代のICが登場すると価格が持ち直す、というもので、2~4年の周期で繰り返される半導体産業の景気循環です。周期的なものではありますが、今回の不況は過去に例をみない深い谷です。世界的な不況と米国でのテロ事件の影響等が重なり、回復の時期は未だ不透明ですが、パソコン関連向けの他にも携帯電話、各種移動体通信、情報家電、ゲーム機、自動車など半導体需要の裾野は確実に拡大しており、半導体製造装置業界は、依然成長市場と考えられています。当社では、次期シリコンサイクルの上昇時に業績拡大できるよう、研究開発の促進、「早く、安く、高品質な製品の生産」を目的とする生産体制の改善等に取り組んでいます。



## 営業の概況



### 1. 当中間期の概況

#### 業績全般

当中間期の半導体業界は、シリコンサイクルが底となっている状況に加え、携帯電話や高速通信網の発展が予想されたほど進まず、昨年後半からの需要の落込みが一段と進み、過去に例をみない大変厳しい状況になっています。さらに、9月11日に米国で発生した同時多発テロの影響で、半導体市況の回復時期についても、不透明感が増し、国内・海外の半導体メーカー各社の設備投資抑制基調は、長引くことが懸念されております。

当社は、このような状況下、営業努力を重ねて受注・売上の増強に努め、一方で生産面のコストダウンに注力いたしました。半導体メーカーの設備投資抑制の影響は避けられず、半導体製造機器部門の売上高・利益は、前年同期対比、減収・減益を余儀なくされました。

計測機器部門につきましても、全般的な景気低迷及びIT不況の影響で、工作機械メーカーをはじめ各種製造メーカーの設備投資は低調でありました。当社は、測定部品の小型化・高精度化の顧客ニーズに対応するとともに、着実な営業努力とコストダウンを推進しましたが、計測機器部門につきましても、前年同期対比、減収・減益となりました。

この結果、当グループの当中間期の連結売上高は、195億6百万円、連結経常利益は、7億65百万円、連結当期純利益は、5億33百万円となりました。

#### 各部門の概況

##### [ 半導体製造用機器部門 ]

厳しい半導体市況の下、各半導体メーカーのニーズに応えるきめ細かい営業を推進する一方、固定費削減、変動比率の引き下げなどの強力なコストダウン施策を推進しましたが、半導体業界の設備投資抑制の影響を受け、売上高は124億58百万円、営業損失が5億77百万円となりました。

主力商品のウェーハプロ - ビングマシンでは、300mmウェーハ対応の高剛性を特徴とする最新鋭機種「UF300A」を開発し、販売を開始しました。お客様から高い支持を得ており、今後の販売増が見込まれます。また、ウェーハダイシングマシンにつきましても、300mmウェーハ対応の「A-WD-300T」が生産性の高いマシンとして機能を高く評価され、売上が順調に伸長しております。

新製品のウェーハ外観検査装置「WIN-WIN 50」とポリッシュ・グラインダ(ウェーハ裏面研磨装置)も、200mm及び300mmウェーハ対応機ともに着実に顧客層を拡大しており、今後、業績進展への寄与が期待されます。

研究開発におきましては、市場ニーズに適合する次世代装置のタイムリーな開発に努力しております。関係会社の株式会社リープルが進めております、100nm～35nmの微細回路製造用電子ビームリソグラフィ装置LEEPLの開発は順調に進んでおり、今年6月に、「LEEPL技術コンソーシアム」が始動いたしました。「LEEPL技術コンソーシアム」は、当社、株式会社リープル及びソニー株式会社が業界各社に呼びかけて、次世代リソグラフィ技術の開発促進並びに普及を目的に、デバイス、マスク、レジスト、装置メーカー全13社で発足し、その後3社が加入し16社となりました。

LEEPLは、次世代リソグラフィ装置の本命として、脚光を浴びておりますが、今後、開発が一層加速され、リープル事業が当社のコア事業に成長するものと予想されます。

##### [ 計測機器部門 ]

当社は、需要が低迷するなかで、お客様の限られた設備投資を確実に受注に取込む営業努力を行い、生産面でも固定費の圧縮に努めました結果、売上高は、70億48百万円、営業利益は、12億91百万円となりました。

自動計測機器では、「パルコム」シリーズが流体軸受向けなどに好調に推移しました。また、汎用計測機器では、世界最高精度を誇る表面粗さ測定機「サーフコム3000A」や高精度で好評の真円度測定機「ロンコム」シリーズの売上が伸長しました。

当社計測機器部門は、かねてより高い成長が期待される光通信関連の計測機器を開発してまいりましたが、今年9月に、当社とNTTアドバンステクノロジー株式が共同開発した光コネクタ端面自動傷検査装置「CEI-1000A」と当社開発のフェルルール同心度測定機「FCM-5000A」を、新製品として販売開始いたしました。

いずれの製品もお客様の製品の量産化や生産の効率化に役立つ優れた特長を有しており、今後積極的に拡販してまいります。

#### 連結キャッシュ・フロー

当中間期の営業、投資キャッシュ・フローは、マイナスとなり、財務活動により補いました。今後は、新製品の売上拡大等により、営業活動によるキャッシュ・フローは好転する予定で、投資活動も平準化することから、より良い財務状況を構築できる見込みです。

#### 株式会社東精エンジニアリングの上場

当社の連結子会社である株式会社東精エンジニアリングは、平成13年6月22日付で東京証券取引所市場第二部に株式上場いたしました。同社は、自動計測機器部門、半導体製造装置部門、計測機器サービス部門の三部門を展開し、業績は着実に伸長しています。上場を機に一層の躍進を目指します。

## 2. 通期の見通し

現状の半導体市場は、IT投資の減速、世界規模の個人需要の停滞に、9月に発生した同時多発テロの影響が加わり、過去に例を見ない厳しい状況にあります。下期につきましても、半導体需要の低迷と半導体メーカーの設備投資抑制が継続するものと予想されます。

当社はかかる市場環境を踏まえ、半導体製造用機器部門の下期見通しを厳しく捉えて、マーケットシェアの高いウェーハブローピングマシン等の既存製品は、上期比さらに減収となるものと考えております。一方、ウェーハ外観検査装置などの新製品



今春竣工したクリーンルーム完備の八王子工場新本館

も研究開発向けの投資から量産ライン用に需要が着実に伸長しているため、市場全体の設備投資抑制の影響を避けられない状態になっています。しかしながら、これら新製品群の売上は拡大しており、半導体製造装置売上全体に占める割合も、着実に上昇しております。

一方、計測機器部門につきましては、景気低迷により需要は減少しつつあるものの、顧客ニーズを踏まえた緻密な営業努力と光通信関連の新製品の拡販などを進め、下期もほぼ上期と同水準の売上高を予定しています。

以上のような予測の下、2001年度の連結売上高は360億円(前年同期比50.8%減)、連結経常損失は6億円、連結当期損失は9億円と予想しております。

## 3. 配当政策

当期の配当金につきましては、厳しい状況下ではありますが、下記理由から平成13年9月期中間配当15円、平成14年3月期配当15円、年30円配当の継続を予定しています。

半導体産業は、市況の急進・急落があるので短期の業績を直ちに配当に反映させることは、長期的視点で保有いただいている株主の皆様視点と合致しないこと。

当社の財務状況と今後のキャッシュ・フロー、及び平成13年9月末未処分利益121億73百万円から、30円配当継続には無理のないこと。

## 新製品紹介

### 計測事業分野

情報の伝達量の増加や伝達速度の高速化を背景に、光通信関連市場は、今後益々拡大していくと予想されます。東京精密は、急速に拡大する光通信の要素部品であるフェルール、光ファイバ等の量産化ニーズに対応する計測機器市場に参入致しました。まず、2001年9月に次の2機種を市場投入致しました。

#### 光コネクタ端面自動傷検査装置「CEI-1000A」

光コネクタ端面自動傷検査装置とは、光コネクタのファイバ端面の傷・くぼみ・汚れ等の欠陥を自動で検査する事を世界で初めて実用化した装置です。光コネクタは、ファイバ端面に欠陥があると光の伝達効率を下げってしまうことから、傷検査は重要な工程とされています。しかし、これまで、光学顕微鏡での目視検査で対応していました。当社の「CEI-1000A」装置により欠陥を自動検出し定量評価が可能となるため、光コネクタの量産化ニーズに対応できます。

なお「CEI-1000A」は、光通信関連機器のバイオニア的存在であるNTTアドバンステクノロジ㈱との共同開発製品です。

光コネクタ端面自動傷検査装置「CEI-1000A」



フェルール同心度測定機「FCM-5000A」



#### フェルール同心度測定機「FCM-5000A」

フェルールとは、光ファイバ同士を正確に接続するコネクタ部品の一つで、高精度の加工が必要とされており、同心度についても高い精度が要求されています。フェルールの同心度が大きければ、光ファイバの接続にズレが生じ、光の伝達効率を下げってしまうことから、同心度測定は、フェルールの生産ラインで重要な検査工程とされています。

東京精密の「FCM-5000A」は、静圧空気軸受受心方式(特許出願中)を採用することにより、従来V台方式に比べ、2倍以上の高精度測定と3倍以上のスピード測定が可能になりました。また、プラスチックや金属など軟質で傷が生じやすい材料への対応も可能になり、お客様から高い評価を得ています。

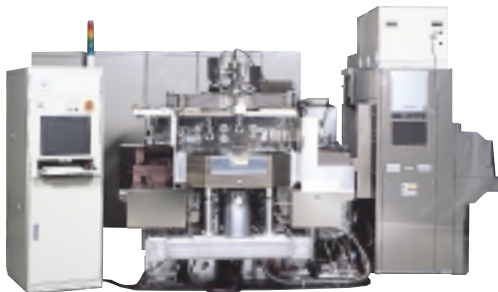
## 半導体事業分野

### 次世代リソグラフィ装置LEEPLの開発進捗状況

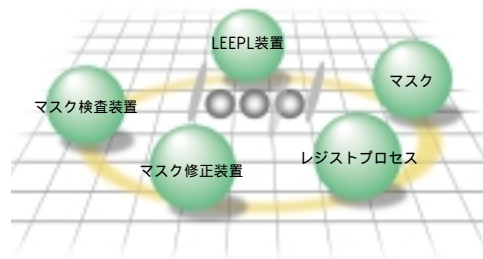
次世代(デザインルール100ナノメートル以下)リソグラフィ装置として注目されているLEEPLシステム(\*1)は、電子ビームリソグラフィと等倍X線リソグラフィで培われた技術資産を融合し発展させたものです。従来の光学式露光装置が「光」と「4倍マスク」を用いているのとは異なり、LEEPLは「低加速の電子ビーム」と「等倍マスク」を採用し、高解像度・高生産性・低価格という、次世代リソグラフィ装置に期待される要素をクリアした革新的な装置です。今後の半導体製造技術の発展に大いに貢献できる製品として期待されています。

LEEPLシステムの開発を開始してから約1年目にあたる今年6月14日には、LEEPL技術の開発促進及び普及を目的に、東京精密とソニー株式会社を发起人とする「LEEPL技術コンソーシアム」が設立され、半導体メーカー3社をはじめ、

LEEPL 機 (側面より撮影)



### LEEPLリソグラフィのトータル・プロセス



LEEPLプロセスの課題をクリアするためにマスクとレジストプロセスのそれぞれの専門メーカーなど13社が会員としてスタートしました。その後半導体メーカー1社、材料メーカー2社が加わり、会員数は16社になりました。

LEEPLシステムの開発計画は予定通り進捗しており、量産機の機能を全て備えた試作機である 機が年内に完成する予定です。来年1年間かけて、半導体メーカーで 機を評価して頂き、量産機に仕上げ、2003年4月頃に市場投入する予定です。

\*1: 低エネルギーの電子ビームで半導体ウェーハ上に微細回路を転写する新しいタイプの電子ビームリソグラフィ装置

## 中間連結貸借対照表

単位:千円

科目	前連結会計年度末 (01.03.31)	当中間連結会計期間末 (01.09.30)
	金額	金額
<b>流動資産</b>	69,043,723	60,128,849
現金及び預金	6,990,699	4,888,602
受取手形及び売掛金	27,253,135	16,776,214
たな卸資産	32,315,814	36,976,879
未収消費税等	807,069	135,629
繰延税金資産	1,186,646	753,281
その他	567,918	667,696
貸倒引当金	77,560	69,454
<b>固定資産</b>	22,433,053	23,375,622
(有形固定資産)	(11,243,858)	(12,631,677)
建物及び構築物	6,460,170	6,268,815
機械装置及び運搬具	2,348,008	2,370,448
工具器具備品	792,714	884,535
土地	805,337	2,916,779
建設仮勘定	837,626	191,099
(無形固定資産)	(6,566,636)	(6,369,585)
ソフトウェア	6,419,901	6,217,978
その他	146,734	151,606
(投資その他の資産)	(4,622,559)	(4,374,359)
投資有価証券	2,853,302	2,417,102
長期貸付金	173,238	139,069
繰延税金資産	1,120,487	1,280,046
その他	520,209	599,449
貸倒引当金	44,678	61,308
<b>繰延資産</b>	367	322
社債発行差金	367	322
<b>資産合計</b>	91,477,144	83,504,795

科目	前連結会計年度末 (01.03.31)	当中間連結会計期間末 (01.09.30)
	金額	金額
<b>流動負債</b>	43,136,614	33,439,978
支払手形及び買掛金	21,253,111	10,035,188
短期借入金	11,120,000	19,708,200
一年以内に返済する 長期借入金	205,592	287,244
未払法人税等	4,862,608	511,391
賞与引当金	1,023,531	836,235
その他	4,671,769	2,061,717
<b>固定負債</b>	9,256,673	10,600,257
社債	250,000	250,000
転換社債	53,000	51,000
長期借入金	5,894,184	7,081,484
退職給付引当金	2,812,431	2,871,027
役員退職慰労引当金	247,058	346,746
<b>負債合計</b>	52,393,287	44,040,236
<b>少数株主持分</b>	304,509	1,694,793
<b>資本</b>		
資本金	7,014,022	7,015,022
資本準備金	11,591,203	11,592,201
連結剰余金	20,401,599	19,581,945
その他有価証券評価差額金	250,830	419,363
為替換算調整勘定	23,759	461
自己株式	407	501
<b>資本合計</b>	38,779,347	37,769,765
<b>負債、少数株主持分及び資本合計</b>	91,477,144	83,504,795

# 中間連結損益計算書

単位:千円

科 目	前中間連結会計期間(00.04.01～00.09.30)		当中間連結会計期間(01.04.01～01.09.30)	
	内 訳	合 計	内 訳	合 計
I 売上高		34,636,127		19,506,579
II 売上原価		21,850,140		13,245,390
売上総利益		12,785,987		6,261,189
III 販売費及び一般管理費				
販売費	4,188,250		4,000,897	
一般管理費	1,436,493	5,624,744	1,546,372	5,547,269
営業利益		7,161,242		713,919
IV 営業外収益				
受取利息	24,427		18,069	
受取配当金	67,536		92,667	
その他	167,290	259,254	174,107	284,844
V 営業外費用				
支払利息	66,122		107,342	
その他	101,345	167,468	126,298	233,641
経常利益		7,253,028		765,123
VI 特別利益				
退職給付信託設定益	1,732,091		-	
連結子会社株式売却益	-		1,902,046	
その他	63,568	1,795,660	-	1,902,046
VII 特別損失				
退職給付引当金繰入額	2,836,725		-	
たな卸資産評価損及び廃却損	-		829,438	
その他	350,700	3,187,425	381,842	1,211,281
税金等調整前中間利益		5,861,262		1,455,888
法人税、住民税及び事業税	3,176,216		434,328	
法人税等調整額	582,286	2,593,930	396,910	831,238
少数株主利益		21,662		91,395
連結中間利益		3,245,670		533,254

# 中間連結剰余金計算書

単位:千円

科 目	前中間連結会計期間(00.04.01～00.09.30)		当中間連結会計期間(01.04.01～01.09.30)	
	内 訳	合 計	内 訳	合 計
連結剰余金期首残高		14,836,704		20,401,599
連結剰余金減少高				
配当金	356,661		561,985	
取締役賞与金	64,890		64,890	
自己株式消却額	202,029	623,580	726,033	1,352,908
中間利益		3,245,670		533,254
連結剰余金中間期末残高		17,458,794		19,581,945

## 中間連結財務諸表作成の基本となる事項

### 1. 連結の範囲

- (1) 連結子会社 7社
- (2) 非連結子会社 5社

### 2. 会計処理基準に関する事項

#### (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

##### (イ) 有価証券

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの

中間連結会計期間末の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法による原価法により算定)

時価のないもの

移動平均法による原価法

##### (ロ) たな卸資産

主として、商品・製品・材料及び貯蔵品は先入先出法による原価法、仕掛品は個別法による原価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### (イ) 有形固定資産

定率法、但し、平成10年4月1日以降取得した建物(建物附属設備は除く)については定額法

##### (ロ) 無形固定資産

市場販売目的のソフトウェア

販売見込数量に基づく方法又は残存有効期間に基づく定額法

自社利用のソフトウェア

社内における利用可能期間に基づく定額法

その他の無形固定資産

定額法

#### (3) 繰延資産の処理方法

##### (イ) 社債発行費

支出時に全額費用として処理

##### (ロ) 社債発行差金

社債償還期間にわたり均等償却

#### (4) 重要な引当金の計上基準

##### (イ) 貸倒引当金

債権の貸倒の損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上。

##### (ロ) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額基準により計上。

##### (ハ) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計期間末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間連結会計期間末において発生していると認められる額を計上。

##### (ニ) 役員退職慰労引当金

役員の退任時に支出が予測される役員退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づく中間連結会計期間末支払見込額を計上。

#### (5) 重要なリース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

#### (6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式によっている。

### 3. 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なりリスクが負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっている。

# 中間連結キャッシュ・フロー計算書

単位:千円

科目	前中間連結会計期間 (00.04.01 - 00.09.30)	当中間連結会計期間 (01.04.01 - 01.09.30)	科目	前中間連結会計期間 (00.04.01 - 00.09.30)	当中間連結会計期間 (01.04.01 - 01.09.30)
	金額	金額		金額	金額
営業活動によるキャッシュ・フロー			II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前中間利益	5,861,262	1,455,888	定期預金の預入による支出	211,835	187,004
減価償却費	744,872	886,930	定期預金の払出による収入	170,000	150,000
退職給付引当金の増加額	143,465	58,596	有価証券・投資有価証券の 取得による支出	272,157	203,097
退職給付信託設定に伴う その他有価証券の減少額	998,069	-	関係会社有価証券の取得 による支出	200,000	4,706
役員退職慰労引当金の増減額	93,795	99,687	有価証券・投資有価証券の 売却による収入	41,307	-
受取利息及び受取配当金	91,963	110,736	連結子会社株式の売却に よる収入	-	1,861,200
支払利息	66,078	130,698	有形・無形固定資産の取得 による支出	1,339,531	4,250,862
投資有価証券売却益	23,320	-	有形固定資産の売却 による収入	22,672	5,218
連結子会社株式売却益	-	1,902,046	貸付金の回収による収入	17,775	34,169
有形固定資産除却・売却損	99,876	4,816	投資活動によるキャッシュ・フロー	1,771,768	2,595,083
有価証券・ゴルフ会員権評価損	251,536	355,379	III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
たな卸資産評価損及び廃却損	-	829,438	短期借入金増減額(純額)	4,961,000	8,588,200
売上債権の増減額	7,127,577	10,476,921	長期借入れによる収入	1,000,000	1,400,000
たな卸資産の増加額	7,060,829	5,164,652	長期借入金の返済による支出	258,637	131,048
販売用ソフトウェアの増減額	935,692	206,094	連結子会社の増資による収入	-	1,353,600
仕入債務の増減額	7,551,698	11,217,922	自己株式の消却による支出	202,029	726,033
取締役賞与の支払額	64,890	64,890	配当金の支払による支出	356,661	561,985
その他営業活動による収入(支出)	802,533	591,930	その他財務活動による収入(支出)	2,014	96
小計	1,121,325	4,547,728	財務活動によるキャッシュ・フロー	5,145,686	9,922,636
利息及び配当金受取額	92,012	31,241	IV 現金及び現金同等物に 係る換算差額	45,364	23,297
利息の支払額	66,078	141,324	V 現金及び現金同等物の増減額	938,554	2,139,101
法人税等の支払額	3,537,258	4,785,545	VI 現金及び現金同等物の期首残高	6,232,115	6,785,863
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,389,998	9,443,356	VII 現金及び現金同等物期末残高	7,170,669	4,646,762

## 中間貸借対照表( 単独決算 )

単位:千円

科 目	前会計年度末 ( 01.03.31 )	当中間会計期間末 ( 01.09.30 )
	金額	金額
( 資産の部 )		
流動資産	62,773,327	54,696,934
現金及び預金	3,863,088	2,694,541
受取手形	1,237,134	1,059,909
売掛金	26,851,103	16,763,136
たな卸資産	26,170,417	30,332,374
未収消費税等	796,466	204,923
繰延税金資産	802,304	472,314
その他	3,060,712	3,174,301
貸倒引当金	7,901	4,566
固定資産	21,991,374	22,315,603
( 有形固定資産 )	(7,952,970)	(8,640,775)
建物及び構築物	4,595,483	4,512,942
機械装置	1,622,721	1,687,802
土地	433,706	1,528,421
その他	663,683	720,508
建設仮勘定	637,374	191,099
( 無形固定資産 )	(6,448,751)	(6,257,139)
ソフトウェア	6,410,060	6,208,976
その他	38,690	48,163
( 投資等 )	(7,589,652)	(7,417,687)
投資有価証券	2,764,926	2,332,248
子会社株式	3,195,803	3,378,340
長期貸付金	167,496	134,386
繰延税金資産	998,927	1,139,287
その他	498,618	483,530
貸倒引当金	36,119	50,106
繰延資産	23,333	15,333
社債発行差金	23,333	15,333
資産合計	84,788,035	77,027,871

科 目	前会計年度末 ( 01.03.31 )	当中間会計期間末 ( 01.09.30 )
	金額	金額
( 負債の部 )		
流動負債	39,817,531	31,925,770
支払手形	15,554,378	8,298,399
買掛金	5,654,348	2,046,963
短期借入金	10,000,000	19,000,000
未払金	2,740,340	508,378
未払法人税等	3,841,028	20,580
賞与引当金	727,205	578,416
その他	1,300,229	1,473,032
固定負債	7,874,345	9,009,986
社債	5,400,000	6,400,000
転換社債	53,000	51,000
退職給付引当金	2,230,730	2,272,428
役員退職慰労引当金	190,615	286,558
負債合計	47,691,876	40,935,757
( 資本の部 )		
資本金	7,014,022	7,015,022
法定準備金	12,259,059	12,320,756
資本準備金	11,591,203	11,592,201
利益準備金	667,855	728,554
剰余金	18,067,611	17,173,956
別途積立金	5,000,000	5,000,000
中間( 当期 )未処分利益	13,067,611	12,173,956
( うち中間( 当期 )利益 )	(6,688,853)	(500,062)
その他有価証券評価差額金	244,535	417,119
自己株式	-	501
資本合計	37,096,158	36,092,113
負債及び資本合計	84,788,035	77,027,871

( 注 ) 1. 子会社に対する短期金銭債権 6,333,147千円 5,255,709千円  
 2. 子会社に対する短期金銭債務 4,204,239千円 3,030,307千円  
 3. 子会社に対する長期金銭債権 69,175千円 46,625千円  
 4. 子会社に対する長期金銭債務 5,800,000千円 6,800,000千円  
 5. 主な外貨建資産  
     売掛金 4,190,752千円 3,162,629千円  
     子会社株式 2,500,996千円 2,500,996千円

6. 自己株式数 58株 145株  
 7. 有形固定資産の減価償却累計額 6,777,602千円 7,228,691千円  
 8. 債務保証及び保証類似行為 18,200千円 5,862千円  
 9. 受取手形割引高 4,591,634千円 4,069,336千円  
 10. 役員退職慰労引当金は商法第287条ノ2の引当金であります。

## 中間損益計算書( 単独決算 )

単位:千円

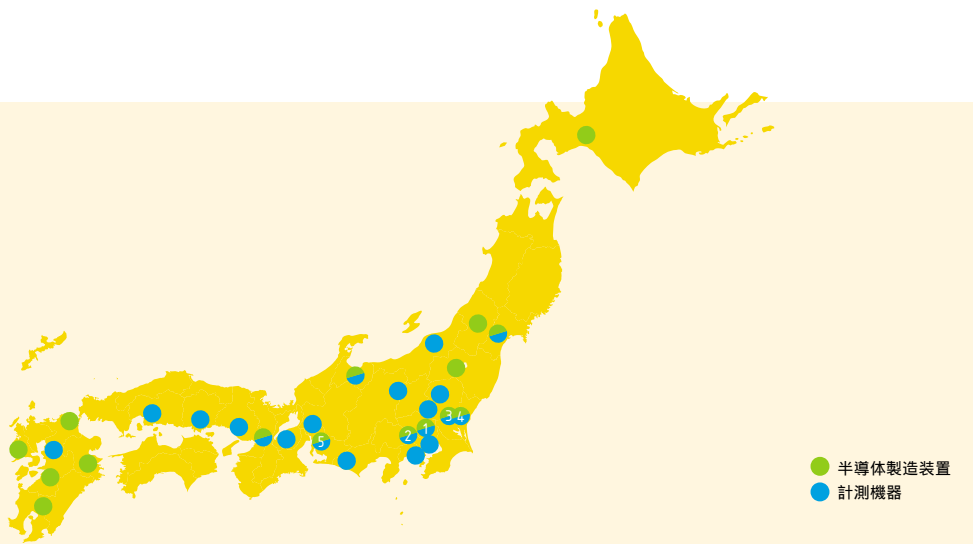
科 目	前中間会計期間( 00.04.01 ~ 00.09.30 )		当中間会計期間( 01.04.01 ~ 01.09.30 )	
	内 訳	合 計	内 訳	合 計
I 売上高		30,882,374		16,175,441
II 売上原価		20,660,585		12,389,770
売上総利益		10,221,788		3,785,671
III 販売費及び一般管理費				
販売費	3,155,383		2,592,658	
一般管理費	1,082,239	4,237,623	1,089,514	3,682,173
営業利益		5,984,164		103,498
IV 営業外収益				
受取利息及び配当金	308,515		442,084	
その他	109,429	417,944	7,585	449,670
V 営業外費用				
支払利息	67,299		121,019	
その他	38,009	105,309	166,179	287,199
経常利益		6,296,800		265,969
VI 特別利益				
退職給付信託設定益	1,732,091		-	
子会社株式売却益	-		1,793,737	
その他	106,080	1,838,171	-	1,793,737
VII 特別損失				
退職給付引当金繰入額	2,629,078		-	
たな卸資産評価損及び廃却損	-		829,438	
その他	350,700	2,979,779	374,218	1,203,656
税引前中間利益		5,155,192		856,049
法人税、住民税及び事業税	2,620,168		41,127	
法人税等調整額	475,344	2,144,823	314,860	355,987
中間利益		3,010,368		500,062
前期繰越利益		7,686,268		12,399,927
自己株式消却額		202,029		726,033
中間未処分利益		10,494,608		12,173,956

(注)子会社との取引高

1. 売上高	4,736,835千円	3,189,547千円
2. 仕入高	5,499,530千円	5,872,436千円
3. 営業取引以外の取引高	51,933千円	61,635千円

# ネットワーク

## 国内主要拠点



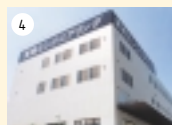
1  
本社



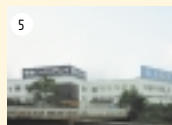
2  
八王子工場  
株式会社エスケイマイクロテクノロジー



3  
土浦工場



4  
株式会社東精エンジニアリング  
本社・工場

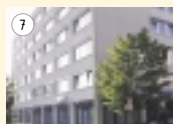


5  
株式会社東精エンジニアリング  
名古屋工場

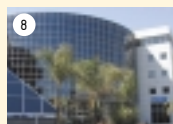
## 海外拠点



6  
TSK America, Inc.



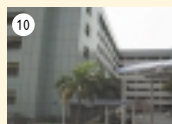
7  
Tokyo Seimitsu  
Europe GmbH



8  
Tokyo Seimitsu  
( Israel ) Ltd.

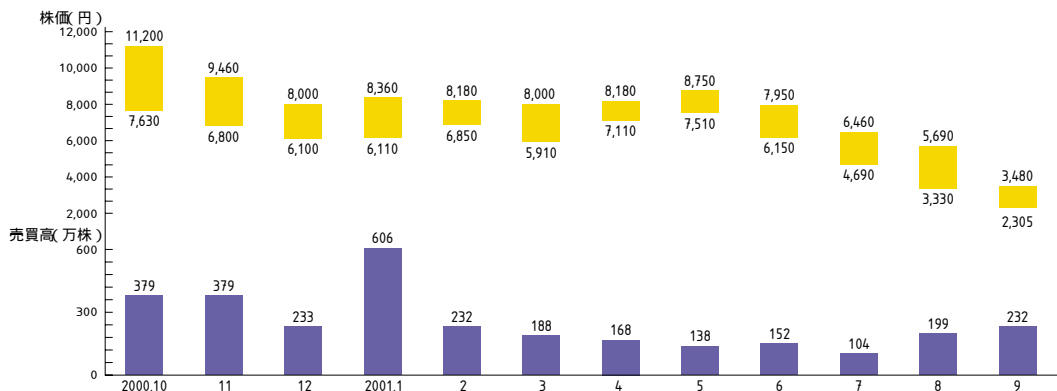


9  
Tokyo Seimitsu  
( Malaysia ) Sdn. Bhd.



10  
Tokyo Seimitsu  
( Singapore ) Pte. Ltd.

## 株価の推移 (平成13年9月30日現在)



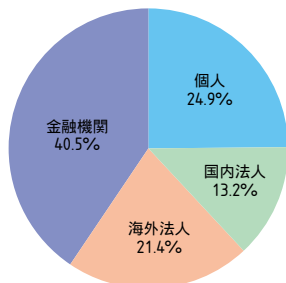
年・月	2000.10	11	12	2001.1	2	3	4	5	6	7	8	9
高値(円)	11,200	9,460	8,000	8,360	8,180	8,000	8,180	8,750	7,950	6,460	5,690	3,480
安値(円)	7,630	6,800	6,100	6,110	6,850	5,910	7,110	7,510	6,150	4,690	3,330	2,305
売買高(万株)	379	379	233	606	232	188	168	138	152	104	199	232

## 株式の状況 (平成13年9月30日現在)

会社が発行する株式の総数	110,501,100株
発行済株式の総数	37,273,867株
当期中の増減	
転換社債の転換による新株発行	1,096株
利益による自己株式の消却	193,000株

株主数 21,029名

### 所有者別状況



### 大株主

株主名	持株数(千株)	出資比率(%)
野村信託銀行株式会社(投信口)	2,167	5.8
東洋信託銀行株式会社	2,108	5.7
三菱信託銀行株式会社(信託口)	1,740	4.7
株式会社富士銀行	1,608	4.3
ザチェスマンハットンバンクエヌエイロンドン	1,572	4.2
日本精工株式会社	1,313	3.5
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	1,259	3.4
三井生命保険相互会社	1,100	3.0
財団法人精密測定技術振興財団	1,058	2.8
安田火災海上保険株式会社	1,001	2.7

東洋信託銀行株式会社の持株数には、信託業務分590千株が含まれております。

## 会社の概況 (平成13年9月30日現在)

<p>商号</p> <p>設立</p> <p>資本金</p> <p>証券取引所 役員</p>	<p>株式会社 東京精密 ( TOKYO SEIMITSU CO., LTD. ) 昭和24年3月28日 7,015,022,314円 東京証券取引所 市場第一部</p> <p>代表取締役社長 大坪 英夫 代表取締役 米国代表 鴻田 道明 代表取締役 C.O.O.計測主幹 川原 栄次 代表取締役 C.O.O.半導体主幹 鈴木 貞勝 代表取締役 C.T.O.企画主幹 薦 清昭 取締役 高城 英明 取締役 伊勢 徹 取締役 森内 信行 取締役 西嶋 尚生 取締役 林 和博 監査役(常勤) 輕部 昭三郎 監査役 坂田 耕四郎 監査役 野口 光</p>	<p>事業所</p> <p>本社</p> <p>技術研究所</p> <p>工場</p>	<p>東京都三鷹市 東京都八王子市 八王子(東京都八王子市) 土浦(茨城県土浦市)</p>
<p>従業員数</p>	<p>662名</p>	<p>営業所</p>	<p>東北(宮城県仙台市) 長野(長野県岡谷市) 山形(山形県山形市) 浜松(静岡県浜松市) 茨城(茨城県土浦市) 名古屋(愛知県三好町) 宇都宮(栃木県宇都宮市) 小牧(愛知県西春町) 埼玉(埼玉県さいたま市) 京滋(滋賀県守山市) 東京(東京都三鷹市) 大阪(大阪府吹田市) 東京(東京都八王子市) 加古川(兵庫県加古川市) 西東京(東京都八王子市) 岡山(岡山県岡山市) 川崎(神奈川県川崎市) 広島(広島県広島市) 新潟(新潟県分水町) 九州(福岡県久留米市) 厚木(神奈川県厚木市) 九州(大分県大分市) 北陸(富山県富山市) (平成13年10月31日現在) (注):全製品取扱 半導体製品取扱 無印:計測・自動計測製品取扱</p>
<p>主要取引銀行</p>	<p>富士銀行 本店 東洋信託銀行 日本橋支店 三井住友銀行 本店 あさひ銀行 吉祥寺支店 東京三菱銀行 新宿中央支店 常陽銀行 土浦支店 関東銀行 本店</p>	<p>国内子会社</p>	<p>株式会社 東精工エンジニアリング 株式会社 ティーエスケイ・マイクロテクノロジー 株式会社 トーセシステムズ 株式会社 東精クリエイト 株式会社 ティーエスケイ・ファイナンス 株式会社 東精ボックス</p>
		<p>海外子会社</p>	<p>TSK America, Inc. Tokyo Seimitsu Europe GmbH Tokyo Seimitsu (Malaysia) Sdn. Bhd. Tokyo Seimitsu (Israel) Ltd. Tokyo Seimitsu (Singapore) Pte. Ltd.</p>
		<p>国内関連会社</p>	<p>株式会社 リーブル</p>
		<p>海外関連会社</p>	<p>三門峡中原精密有限責任公司</p>

## 株主メモ

決算期	毎年3月31日
定時株主総会	毎年6月中 基準日毎年3月31日 その他必要あるときは、あらかじめ基準日を公告いたします。
名義書換代理人	東京都千代田区丸の内一丁目4番3号 東洋信託銀行株式会社
同事務取扱所	〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号 東洋信託銀行株式会社 証券代行部 電話(03)5683-5111(代表)
同取次所	東洋信託銀行株式会社
株式取扱手数料	名義書換 無料 新株券交付 無料
公告掲載新聞	東京都において発行される日本経済新聞

## 株主の皆様へ アンケートのお願い

弊社では、株主の皆様の声を経営に反映させるべく、アンケートを実施させていただきます。お手数ではございますが、アンケートの質問事項をお読みいただき、回答をご記入の上、ご投函下さい。

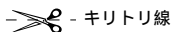
皆様のご協力をお願い申し上げます。

## 弊社資料請求について

弊社資料をご希望の場合は、アンケート用紙の資料請求欄にご記入の上、ご投函下さい。

## 見通しに関する注意事項

この中間事業報告書に掲載されている東京精密の現在の計画、見通し、戦略、その他の歴史的事実ではない事柄は、将来の業績に関する見通しであり、リスクや不確実性を含んでいます。リスクや不確実性には、日本経済の動向、当社の事業領域の市況、為替変動、急速な技術革新による競争の激化などがあります。このような事象により、実際の業績はこれら見通しとは大きく異なる結果となりうることをご承知おき下さい。



- キリトリ線 -

## 株主の皆様へ アンケートのお願い

1. 弊社の株式をご購入された理由は何でしょうか？

- 1) 将来性 2) 収益性 3) 経営理念 4) 事業内容 5) 証券会社に勧められて  
6) その他( )

2. 今後の弊社株式についてどのような方針をお持ちですか？

- 1) 買い増し 2) 保有 3) 売却

また、上記方針を決定するための判断材料は何ですか？

- 1) 株価 2) 配当 3) 将来計画 4) 業績 5) その他( )

3. 今回の事業報告書で興味を持たれた記事はどれでしょうか？

- 1) 株主の皆様へ 2) FAQ 3) 営業の概況 4) 新製品紹介 5) 財務データ  
6) その他( )

4. 今後事業報告書で取り上げて欲しいテーマをお聞かせ下さい。

( )

5. 株式投資歴をお聞かせ下さい。

- 1) 3年未満 2) 3年以上10年未満 3) 10年以上20年未満 4) 20年以上

6. 所有株式数をお聞かせ下さい。

- 1) 100株 2) 200株以上 3) 500株以上 4) 1,000株以上 5) 5,000株以上

7. 弊社株式保有歴をお聞かせ下さい。

- 1) 1年未満 2) 1年以上 3) 3年以上 4) その他( )

8. その他、弊社に対するご意見・ご希望があればお願いいたします。

( )

資料請求(ご希望の資料に丸印をお願いします)

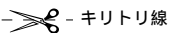
- 1) 会社概要 2) 和文版アニュアルレポート 3) 英文版アニュアルレポート  
4) LEEPL社 会社案内

ご住所 〒

お名前

男性・女性

年齢



郵便はがき



料金受取人払

三鷹局承認  
101

1 8 1 8 7 9 0

差出有効期限  
平成14年4月  
30日まで

東京都三鷹市下連雀9-7-1

株式会社 東京精密  
業務部 総務グループ 宛



東京精密ホームページ

<http://www.accretech.jp>



「投資家の皆様へ」をクリック



IRホームページ

<http://www.accretech.jp/contents/ir.html>

最新のプレスリリース掲載

アニュアルレポート、事業報告書等  
各種IRツールのダウンロードが可能  
な充実したIRライブラリー

決算短信、主要財務指標掲載

決算説明会の状況をオンデマンド  
配信( 決算説明会后3ヶ月間 )

TOKYO SEIMITSU  
<http://www.accretech.jp>